

甘肃迈芯维的AMOLED生产工序

产品名称	甘肃迈芯维的AMOLED生产工序
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

产品详情

LTPS-AMOLED的制作工艺囊括了显示面板行业的诸多行业技术，其主要分为背板段，前板段以及模组段三道工艺。

背板段工艺：通过成膜、曝光、蚀刻叠加不同图形不同材质的膜层以形成LTPS（低温多晶硅）驱动电路，其为发光器件提供点亮信号以及稳定的电源输入。技术难点在于微米级的工艺精细度以及对于电性指标的极高均一度要求。其中镀膜工艺是使用镀膜设备，用物理或化学方式将所需材质沉积到玻璃基板上；曝光工艺是采用光学照射的方式，将光罩上的图案通过光阻转印到镀膜后的基板上；蚀刻工艺是使用化学或者物理的方式，将基板上未被光阻覆盖的图形下方的膜蚀刻掉，然后将覆盖膜上的光阻洗掉，留下具有所需图形的膜层。

前板段工艺：通过高精度金属掩模板（FMM）将有机发光材料以及阴极等材料蒸镀在背板上，与驱动电路结合形成发光器件，再在无氧环境中进行封装以起到保护作用。蒸镀的对位精度与封装的气密性都是前板段工艺的挑战所在。

模组段工艺：将封装完毕的面板切割成实际产品大小，之后再行偏光片贴附、控制线路与芯片贴合等各项工艺，并进行老化测试以及产品包装，呈现为客户手中的产品。